

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2024-058

安徽晶赛科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
业绩说明会
媒体采访
现场参观
新闻发布会
分析师会议
路演活动
其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年12月11日

活动地点：上海浦东新区陆家嘴世纪大道8号丽思卡尔顿酒店

参会单位及人员：东吴证券股份有限公司及报名参加东吴证券2025年度策略会的投资者

上市公司接待人员：董事会秘书胡丹先生

三、投资者关系活动主要内容

董事会秘书胡丹先生介绍了公司业务的基本情况并就投资者关心的问题进行了交流，主要问题及回复概要如下：

问题 1：请问目前石英晶振行业现状

答复：从目前看，随着前期市场库存逐渐消耗完毕，石英晶振行业整体需求有所回暖，但仍处于供大于求的阶段，市场增量不是很明显。产品市场竞争激烈，谐振器品类的竞争尤为突出，部分行业公司正转变发展思路，积极转型，向高端化产品进行布局。

问题 2：请问公司如何看待石英晶振行业未来发展前景

答复：随着全球信息化、数字化进程的加速推进，5G 网络、物联网的逐渐普及，人工智能浪潮的兴起，汽车电子、电力与能源、工业设备、医疗电子等市场的推动，以及国产替代化进程的加速和国家政策的大力支持，市场应用场景扩展和升级，石英晶振行业市场规模仍将呈现增长趋势。

问题 3：请介绍公司超高频晶振产品的应用场景

答复：超高频产品主要是指频率在 100MHZ 以上的晶振，产品主要应用在光模块、光通讯、FTTR(光纤入户)等使用场景。公司目前已经开发出高频光刻晶片，未来将持续加强市场拓展，满足客户多场景的使用需求。

问题 4：请问公司音叉晶振的生产及市场拓展情况

答复：公司音叉晶振产品已完成产能布局，在消费电子、定位模组、电表等业务领域的拓展初见成效。未来，公司将通过加强内部管控、优化工艺流程等管理措施，提高产品的市场竞争力，优化公司产品结构。

问题 5：请介绍公司的光刻工艺

答复：公司的光刻工艺应用于晶振制造及晶片制造方面，主要包括小尺寸晶振、超高频晶振及音叉晶体的制造。

问题 6：公司目前车规级产品的主要应用场景及市场拓展情况

答复：车规级产品主要应用在整车制造、BMS（电池管理系统）、汽车仪表等场景。目前公司已经通过部分汽车电子厂商供应商的认证并实现批量出货，后期

将加大市场拓展力度，积极接洽下游客户，努力提升产品销量。

问题 7：公司将在哪些产品和领域进行重点布局

答复：公司将聚焦高频晶片及小尺寸产品的研发，重点推进音叉晶振、温补晶振等产品的小型化，在汽车电子、光模块等领域进行重点拓展。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日